



# 电子行业联电 21Q4 业绩交流会点评：半导体供需持续紧张 5G、汽车、AIOT 需求旺盛



业绩持续增长，28nm 业务激增带来结构性盈利能力提升，22 年晶圆涨价仍将延续。联电 21 年第四季度营收为 591 亿新台币（21.4 亿美元），环比增加 5.7%，毛利率为 39.1%。环比上升 2.3 个百分点。2021 年全年收入 2130 亿新台币，同比增长了 20.5%。考虑到新台币对美元的升值强劲，以美元计同比增长约为 26-27%。21 年全年毛利率 33.8%，同比增加了 11.7 个百分点。21 年全年 ASP 上涨约 15%，其中 21Q4 涨幅超过 3%。21 年的 asp 上涨更多由于 28nm 的结构性贡献，去年 28nm 收入同比增加 75%。预计晶圆涨价在 2022 年仍将延续，联电预计 22 年涨幅与 21 年相近，其中 22Q1ASP 预计环比增长 5%，将主要由涨价贡献。

资本开支大幅增长，22Q2 开始产能将逐渐开出，设备交期延长带来不确定性。联电 21 年资本开支为 18 亿美元，22 年计划为 30 亿美元，同比增长超过 60%，其中由于设备延迟交付导致 5 亿美元的资本开支由 21 年迁移至 22 年。预计 2022Q2 开始逐渐有新增产能开出，但设备交期延长可能会对扩产进度产生影响。具体扩产计划方面：12A 厂 P5 的 10K 月产能预计在 2022Q2 上线，P6 的 27.5K 月产能预计在 2023Q2 上线。22 年的资本开支将用于 12X 厂 P1 和 12A 厂 P6 的扩产，分别增加 5K 月产能，预计在 2024Q2 开出。总的来看，22 年联电产能将同比增加 6%。

5G、电动车、AIoT 带动半导体市场持续增长，28nm 甜蜜点需求更盛，LTA 体现晶圆代工重要性长期提升。5G、电动车渗透率持续提升、AIOT 产品创新将带动半导体市场呈现增长大趋势，晶圆代工行业规模 22 年预计

将增长 20%，28nm 作为诸多应用如 OLED 驱动、ISP、wifi6、非挥发存储芯片的甜蜜点 (sweatspot)，具有更高性价比。产能扩产仍然有限的背景下（联电预计 22 年晶圆代工总产能同比增长约 6%-10%），这类应用需求的强劲增长将导致供需在较长时间保持紧张。

晶圆代工即使未来出现周期下行趋势，幅度也会更为温和。同时，联电与客户签署的 LTA 长期供货协议或者独供协议已经覆盖了约 80% 的 28nm 产能。这种提前锁定产能的方式一方面使得晶圆厂经营稳定性大幅提升，另一方面也体现了在特色工艺和优质技术平台的加持下，晶圆厂的产业链地位和重要性可能在中长期维度得到提升。

投资建议：我们认为受益于半导体市场增长和国产替代大趋势，国内半导体行业景气度有望持续。具有特色工艺或优质技术平台的晶圆代工厂产业链重要性提升，将有更多议价权。建议关注：华虹半导体；AIoT 赛道长坡厚雪，将带动半导体需求持续增长，建议关注 AIoT 类设计公司：晶晨股份、瑞芯微、恒玄科技、全志科技等。晶圆厂大幅增加资本开支带来大量的半导体设备需求，国内设备厂商将迎来发展机遇。建议关注：北方华创、芯源微、中微公司、至纯科技、盛美上海、长川科技、华峰测控、万业企业等。

风险提示：半导体下游需求不及预期、国际贸易环境风险、研发进度不及预期而研发投入过大带来的相关风险

关键词: 5G LED OLED 涨价 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_36743](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_36743)

